

ORMECON CSN Classic

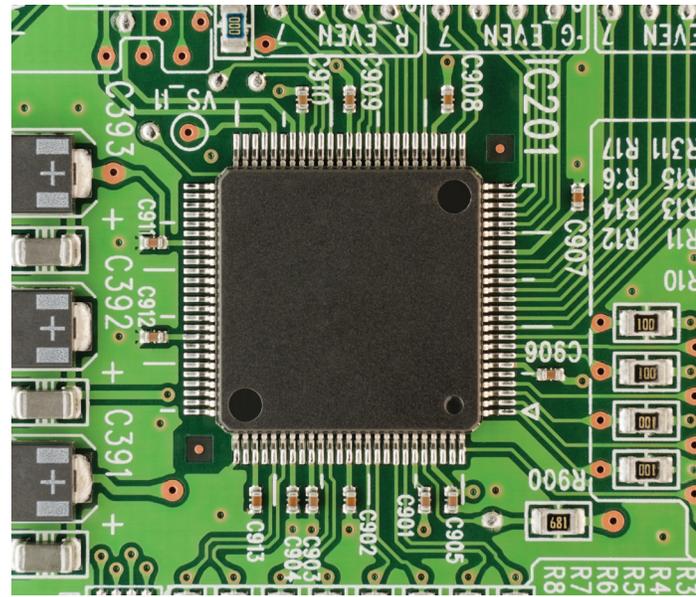
化学沉锡

關鍵應用中值得信赖的可靠性

ORMECON CSN Classic是一款製程非常稳定的化锡制程。由於注册专利的有机金属预浸技術，客戶量產的經驗证明此有機金屬技術可以降低65%的铜-锡扩散速率，并具有极佳的保质期。因此，即使在多次无铅回流焊后，仍具有优秀的焊锡性和外观。

每款ORMECON CSN Classic制程使用一种存在於ORMECON预浸藥水所沉积的纳米金属层，该预浸可以在電路板經過ORMECON主槽化锡前起催化的作用，由此产生的大顆锡晶粒结构可明显减缓了铜 - 锡金属间的扩散，因此使產品具備行业内最长的保质期。有机金属预浸通过形成一种独特的晶体结构，使电路板具有高抗氧化性，能有效抑制铜扩散和锡须形成。

ORMECON CSN Classic制程适用于压接技术、背板和微線路的应用，可提供MSA或硫酸系统，是最灵活的化學沉锡系统。



主要特性优点

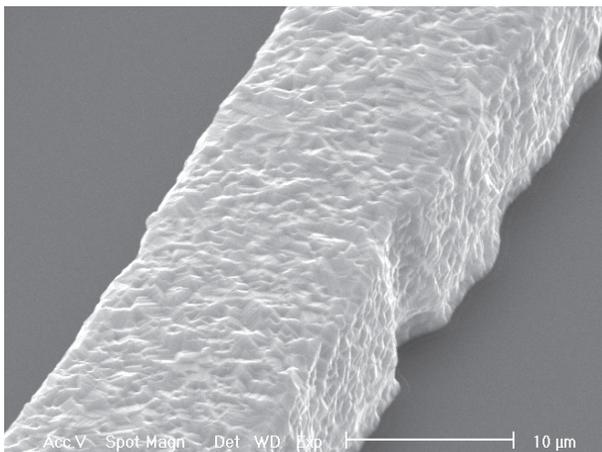
- 汽车電子量产验证的行业领先最终表面处理
- 专利的预浸可将铜-锡扩散降低高达65%
- 容许多次无铅回流焊装配
- 行业中最长的保质期
- 独特的晶体结构可抵抗锡须的形成

ORMECON CSN Classic

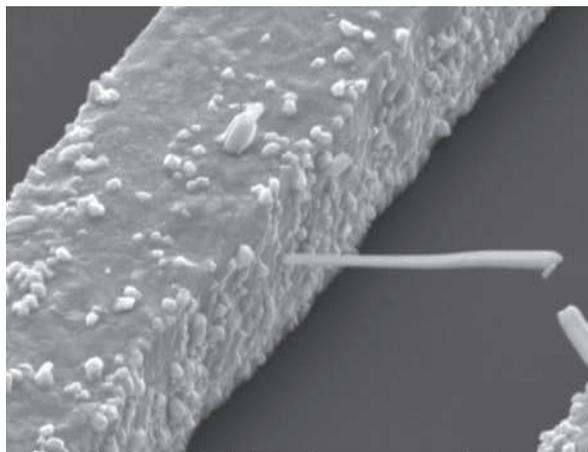
化学沉锡

竞争者根本无法与ORMECON CSN Classic竞争

Ormecon CSNs 专利的预浸为铜扩散到锡中提供了温和的阻絕層，同时还创造了独特的低应力晶粒结构，大大减少了晶须的形成。

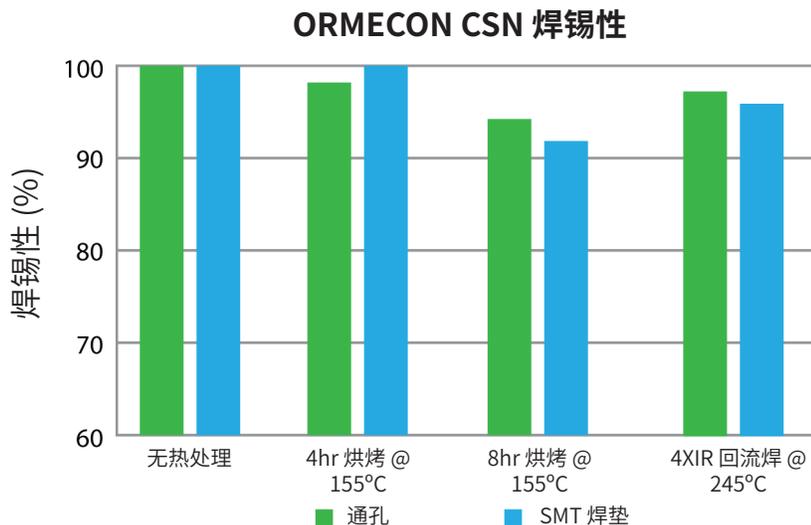


ORMECON CSN Classic 避免锡须形成并提供优秀的焊锡性



竞争对手锡须和焊锡性问题

铅回流焊后无与伦比的焊锡性



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS